

2012年05月18日 星期五

[作者在线注册](#)[作者在线投稿](#)[作者在线查稿](#)[专家在线审稿](#)[读者在线登录](#)[编辑在线办公](#)**稿件标题：**高聚物黏结粉末分步压装成型件性能研究**稿件作者：**梁华琼, 韩超, 雍炼, 冯立羊, 杨永林(60)**录用栏目：**制造技术

**文章摘要：**为获得高聚物黏结粉末分步压装成型技术条件，主要研究了工艺条件对分步压装成型件性能的影响，探索了分步压装成型技术特点。结果说明，分步压装成型界面清晰，无裂纹等质量缺陷，界面结合紧密；而采用一次成型的成型件成型界面比较弯曲、不规则；分步压装可以有效改善模压法一次成型的装药质量，解决模压法成型件的轴向密度均匀性问题，有效提高装药质量；分步压装的预成型压力值对成型件界面的影响非常重要，预成型压力值应为成型压力的45%~60%。

**关键词：**高聚物黏结粉末；分步压装；一次成型；装药质量；成型界面**收录刊物：**2010年07期**稿件基金：****引用本文格式：****浏览次数：**149**下载次数：**88

Download ↓

**作者园地**

- ▶ 新手上路
- ▶ 密码找回
- ▶ 作者留言
- ▶ 投稿帮助
- ▶ 问题解答
- ▶ 中图分类号简...

**投稿指南**

- ▶ **投稿要求—投稿必读**
- ▶ 文后参考文献著录规则
- ▶ 投稿须知—投稿必读
- ▶ 写作模版—投稿必读
- ▶ 保密协议—投稿必读
- ▶ 专家审稿单
- ▶ 中图分类号、文献标识码

**期刊目录**

2012年02期  
2012年01期  
2011年12期  
2011年11期  
2011年10期  
2011年09期  
2011年08期

**文章检索**检索项：检索词：[浏览排行榜](#) [下载排行榜](#)**友情链接**

- ▶ 中国兵工学会
- ▶ 同数期刊OA系统
- ▶ 中国科技论文在线
- ▶ 重庆与世界杂志

《含能材料》杂志

▶ 重庆邮电大学学报

▶ 西南大学学报

▶ 万方数据库

▶ 维普资讯网

▶ 中国知网

▶ 《电子元器件应用》杂志

▶ 《电光与控制》杂志

地址：重庆市九龙坡区重庆理工大学杨家坪校区图书馆大楼16楼期刊社 邮编：400050

咨询电话：023-68852703 传真号码：023-68852703 电子邮箱：scbgxb@126.com

技术支持：重庆同数科技 前台管理 工作入口

您是第 **391241** 位访问者